



kingston.com/epop

ePoP

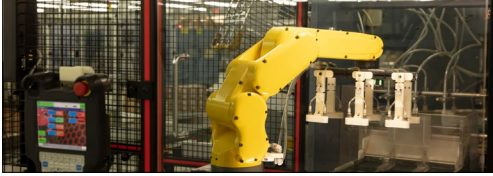
หน่วยความจำแบบแพ็คเกจบนแพ็คเกจฝังตัวสำหรับอุปกรณ์สวมใส่

ePoP ของ Kingston มอบชิ้นส่วนมาตรฐาน JEDEC ที่มีการรวมกันอย่างสมบูรณ์ซึ่งรวมหน่วยความจำ Embedded MultiMedia Card (eMMC) และ Low-Power Double Data Rate (LPDDR) DRAM เข้าด้วยกันในโซลูชัน Package-on-Package (PoP) ePoP ติดตั้งอยู่เหนือระบบที่อยู่บนชิป (SoC) โดยตรง ที่รองรับ ซึ่งช่วยลดพื้นที่แผงวงจรพิมพ์ (PCB) และรับประกันประสิทธิภาพการทำงานที่เหมาะสมที่สุด ePoP เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันที่มีข้อจำกัดด้านพื้นที่ เช่น อุปกรณ์สวมใส่

จุดเด่นที่สำคัญ

- การติดตั้งอยู่เหนือระบบที่อยู่บนชิป (SoC) โดยตรงทำให้ ePoP เป็นโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับแอปพลิเคชันที่มีฟอร์มแฟกเตอร์ขนาดเล็ก เช่น อุปกรณ์สวมใส่
- ช่วยให้การออกแบบระบบง่ายขึ้น ลดเวลาในการออกสู่ตลาด และยืดระยะเวลาในการตรวจสอบคุณภาพ
- มีการกำหนดค่าเฟิร์มแวร์หลายรูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณในด้านประสิทธิภาพการทำงาน พลังงาน และอายุการใช้งาน

กลุ่มตลาด



IoT



อุปกรณ์สวมใส่



อุปกรณ์ความจริงเสริม (AR) / ความจริงเสมือน (VR)

หมายเลขชิ้นส่วนและข้อมูลจำเพาะสำหรับ ePOP

ePoP มาตรฐาน LPDDR4x

หมายเลขชิ้นส่วน	ความจุ		คำอธิบาย		แพ็คเกจ	FBGA	อุณหภูมิในการทำงาน
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(มม.)		
64EP16-M4MTB9W	64	16	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.6	144	-25°C ~ +85°C
64EP32-M4NTB9W	64	32	5.1	LPDDR4x	8x9.5x0.65	144	-25°C ~ +85°C

ePoP มาตรฐาน LPDDR5x

หมายเลขชิ้นส่วน	ความจุ		คำอธิบาย		แพ็คเกจ	FBGA	อุณหภูมิในการทำงาน
	NAND (GB)	DRAM (Gb)	eMMC	DRAM	(มม.)		
64EP16-M5ATB9W	64	16	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.58	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9G	64	32	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.65	201	-25°C ~ +85°C
64EP32-M5BTB9M	64	32	5.1	LPDDR5x	8x9.5x0.7	201	-25°C ~ +85°C

